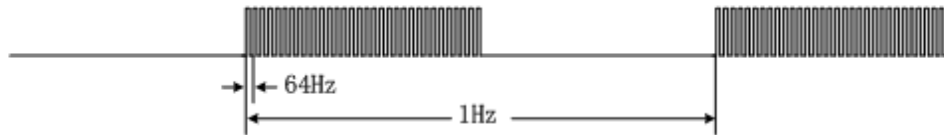


LCD 闪动显示 IC

FEATURES 特点

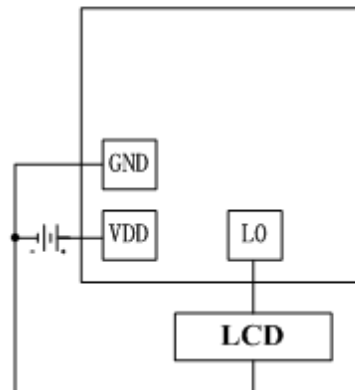
工作模式：加电工作，闪动波形如下：



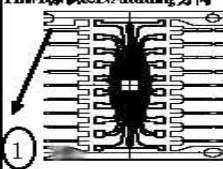

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性

Characteristics		Sym	Min	Typ	Max	Unit	REMARKS
Operating Voltage	工作电压	Vdd	-	3	-	V	-
Operating Current	工作电流	Iop	-	1	3	μA	-
Output Current	输出电流	Io	1	-	-	mA	-
Flash Frequency	闪动频率	Fkd	-	1	-	Hz	-
Operating Frequency	LCD 工作频率	-	-	64	-	HZ	-
Oscillator input Frequency	振荡频率	Fosc	-	8	-	KHz	-

APPLICATION DIAGRAM 参考电路图



注：* 芯片衬底接 VDD 或悬空。

BONDING DIAGRAM	客户 Customer		芯片名 wafer name		生效日期 Effective date	
	封装形式 PKG	DIP18	型号 Device		版次 Rev	A
Pin#1标识&D/Aloading方向 	备注及特殊要求 (Remark&Special Instruction) :					
客户签字： <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; margin: 5px 0;"></div>						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 封装规格 Width: 300mil Pitch: 2.54mm ROHS: <input checked="" type="checkbox"/> Green: <input type="checkbox"/> </div>						
						
芯片尺寸 Die size	750umX590um	偏移值 (x, y)	引线框 Lead frame	DIP18 85#85	粘片胶 型号	导电胶 衬底接VDD
芯片厚度 Thic kness	400um±20um	旋转角度 (θ)	PAD size	110umX110um	树脂 型号	RE VIEWER
丝直径 Wire size	镀钎20um	焊线条数 Total wires	劈刀 Capillary	150um		APPROVAL
		3				Date

PAD坐标:
 VDD: 80, 80
 GND: 80,230
 LO: 420,80